

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Capacitance value/ Kapazitätswert:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
24-011613	3	Gold flash over nickel <i>Gold über Nickel</i>	370 pF ± 20 %
24-011612	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-011611	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-011623	3	Gold flash over nickel <i>Gold über Nickel</i>	830 pF ± 20 %
24-011622	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
24-011621	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	

**Technical specification/**

**Technische Daten:**

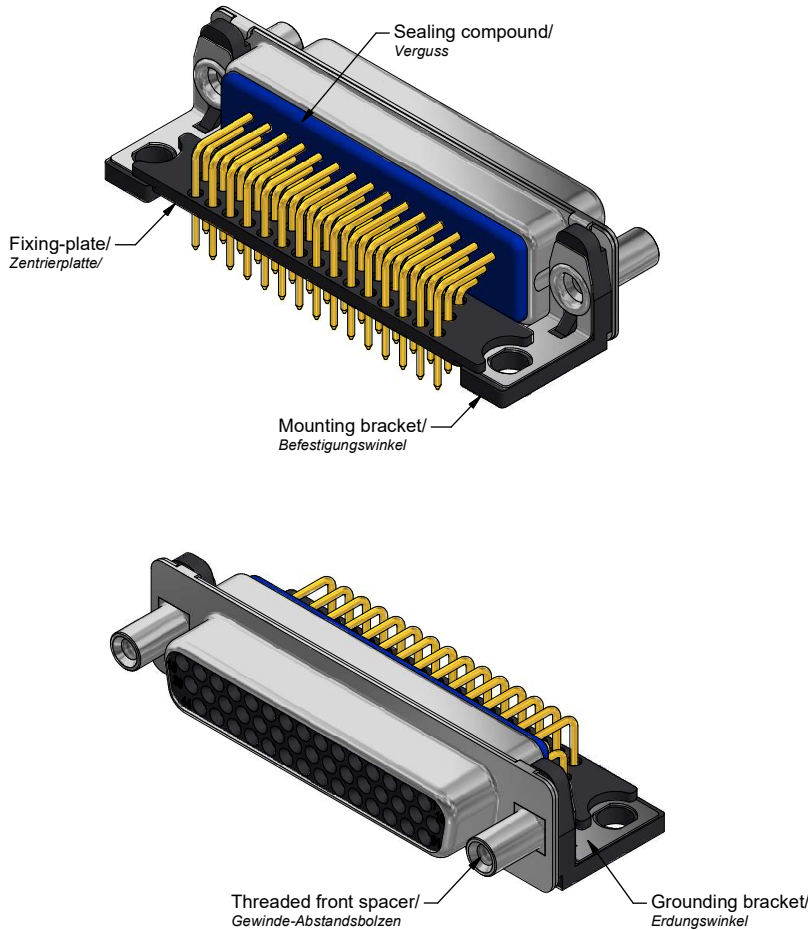
Working voltage/ Betriebsspannung:	100 VDC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	2,5 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 1 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV):	300 VDC
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 85 °C
Capacitance value/ Kapazitätswert:	see table/ <i>siehe Tabelle</i>
Mating cycles (see table)/ Steckzyklen (siehe Tabelle):	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

**Materials/  
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni Contact tails pretinned/ Kontaktspitzen verzinkt
Insulator/ Isolierkörper:	High temp. PA UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded front spacer/ Gewinde-Abstandsbolzen:	Cu alloy, Sn over Ni
Mounting bracket/ Befestigungswinkel:	High temp. PA UL 94 V-0
Grounding bracket/ Erdungswinkel:	Cu alloy, Sn
Fixing-plate/ Zentrierplatte:	High temp. PA UL 94 V-0
Sealing compound/ Verguss:	PUR

**Installation specification/  
Montagedaten:**

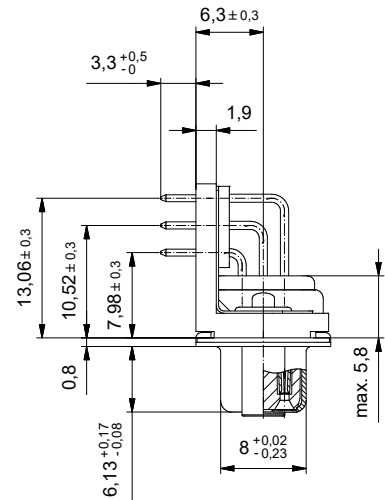
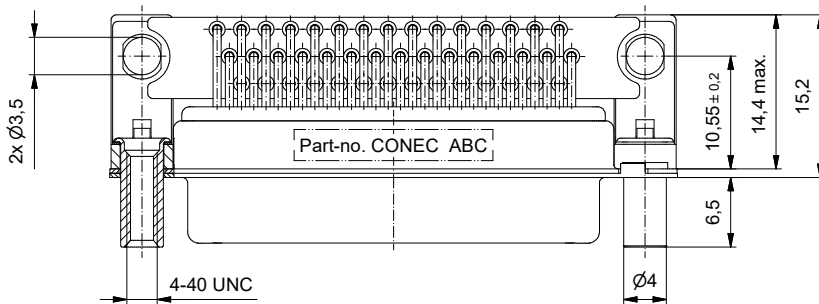
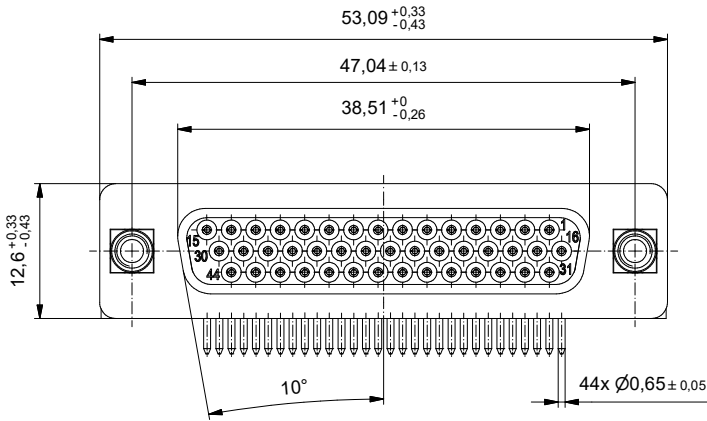
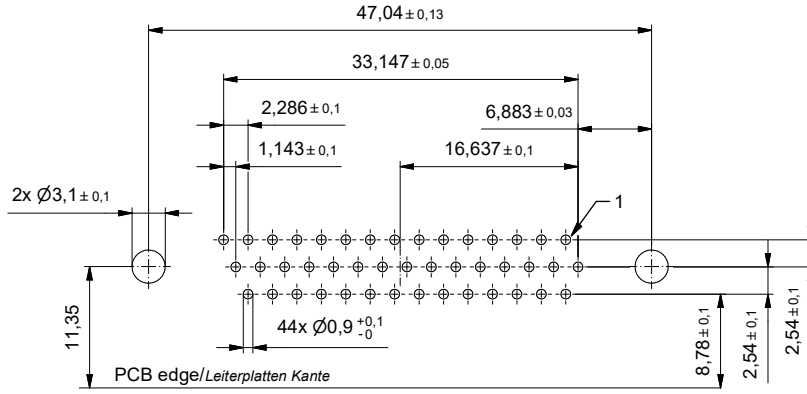
Solder parameter/ Lötparameter:	
Solder preheat temperature/ Vorheiztemperatur:	100 °C for 30 sec./ 100 °C für 30 Sek.
Solder bath temperature/ Lötbadtemperatur:	260 °C for 5 sec./ 260 °C für 5 Sek.
PCB hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/ <i>siehe Seite 2</i>
Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm



		D-SUB HD C-Filter Female 44pos. Solder pin angled 0.350 inch with threaded front spacer, mounting bracket, fixing plate and grounding bracket							
		D-SUB HD C-Filter Buchse 44pol. Lötstift gewinkelt 7,98 mm mit Gewinde-Abstandsbolzen, Befestigungswinkel, Zentrierplatte und Erdungswinkel							
Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date/Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.06.2023</td> <td>Bub</td> </tr> <tr> <td>13.06.2023</td> <td>Lehmenkühler</td> </tr> </tbody> </table>	Date/Datum	Name	12.06.2023	Bub	13.06.2023	Lehmenkühler	dwg no / Z.-nr.: 24K1A2492
Date/Datum	Name								
12.06.2023	Bub								
13.06.2023	Lehmenkühler								
RoHS compliant/konform		<b>CONEC</b>	DIN-A3 1 / 2						

The reproduction, distribution and sale of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. We reserve the right to withdraw advertising and/or to terminate the use of the website at any time without notice and to take legal action.

PCB hole drillings  
(PCB top side)  
Leiterplattenbohrbild  
(Leiterplatten Oberseite)



Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1		dim. in mm	D-SUB HD C-Filter Female 44pos. Solder pin angled 0.350 inch with threaded front spacer, mounting bracket, fixing plate and grounding bracket	DIN-A3 2 / 2				
			<table border="1"> <tr> <th>Date/Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>12.06.2023</td> <td>Bub</td> </tr> <tr> <th>appd./gepr.</th> <th>Lehmenkühler</th> </tr> </table>	Date/Datum		Name	12.06.2023	Bub	appd./gepr.
Date/Datum	Name								
12.06.2023	Bub								
appd./gepr.	Lehmenkühler								
dwg no / Z.-nr.:	24K1A2492								
RoHS compliant/konform				D-SUB HD C-Filter Buchse 44pol. Lötstift gewinkelt 7,98 mm mit Gewinde-Abstandsboizen, Befestigungswinkel, Zentrierplatte und Erdungswinkel					

The reproduction and circulation of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Otherwise will be held liable for the payment of damages.  
 Die Weitergabe sowie die Verbreitung dieses Dokuments, die Kommunikation seiner Inhalte mit anderen, ohne schriftliche Genehmigung der CONEC AG, ist ausdrücklich untersagt. Sonstige Verantwortlichkeiten werden vorbehalten.  
 The reproduction and circulation of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Otherwise will be held liable for the payment of damages.  
 Die Weitergabe sowie die Verbreitung dieses Dokuments, die Kommunikation seiner Inhalte mit anderen, ohne schriftliche Genehmigung der CONEC AG, ist ausdrücklich untersagt. Sonstige Verantwortlichkeiten werden vorbehalten.